

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年11月8日(2012.11.8)

【公開番号】特開2011-91238(P2011-91238A)

【公開日】平成23年5月6日(2011.5.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-018

【出願番号】特願2009-244274(P2009-244274)

【国際特許分類】

H 05 K 9/00 (2006.01)

【F I】

H 05 K 9/00 J

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月21日(2012.9.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、前記基板の一方の面及び他方の面に搭載された電子部品と、前記基板の他方の面に搭載された前記電子部品の周囲を覆うシールドと、を備え、

前記シールドは、前記基板に固着して立設し前記電子部品の側方を覆う側壁部と、当該側壁部に支持され前記基板の面に対して離間して位置し前記電子部品の上方を覆う天板部と、を備え、

前記シールドの前記側壁部のうち、前記基板の前記一方の面側に前記電子部品が配置されている箇所に位置する前記側壁部の一部を切除した、

回路基板。

【請求項2】

請求項1に記載の回路基板であって、

前記基板の前記他方の面上における前記シールドの前記側壁部の前記切除箇所が形成された箇所に、配線を敷設した、

回路基板。

【請求項3】

請求項2に記載の回路基板であって、

前記基板の前記他方の面上に配置された前記電子部品に接続された配線を、当該電子部品の周囲を覆うよう配置された前記シールドに形成された前記側壁部の前記切除箇所に敷設した、

回路基板。

【請求項4】

請求項2に記載の回路基板であって、

前記基板の前記他方の面上に配置された2つの前記電子部品の間を接続する配線を、当該各電子部品のそれぞれの周囲を覆うよう配置された2つの前記シールドに形成された各前記側壁部の各前記切除箇所に敷設した、

回路基板。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれか一項に記載の回路基板であって、

前記シールドの前記側壁部の前記切除箇所を、前記一方の面側に前記電子部品が配置さ

れている箇所よりも広く形成した、
回路基板。

【請求項 6】

基板と、前記基板の一方の面及び他方の面に搭載された電子部品と、前記基板の他方の面に搭載された前記電子部品の周囲を覆うシールドと、を備えた回路基板と、

前記回路基板を収容する筐体と、を備え、

前記シールドは、前記基板に固着して立設し前記電子部品の側方を覆う側壁部と、当該側壁部に支持され前記基板の面に対して離間して位置し前記電子部品の上方を覆う天板部と、を備えると共に、

前記シールドの前記側壁部のうち、前記基板の前記一方の面側に前記電子部品が配置されている箇所に位置する前記側壁部の一部を切除した、

電子機器。

【請求項 7】

請求項 6 に記載の電子機器であって、

前記基板の前記他方の面上における前記シールドの前記側壁部の前記切除箇所が形成された箇所に、配線を敷設した、

電子機器。

【請求項 8】

基板の一方の面及び他方の面に電子部品を配置すると共に、少なくとも前記基板の他方の面に前記電子部品を配置したのちに当該電子部品の周囲を覆うシールドを配置し、

前記基板の他方の面に配置する前記シールドは、前記基板に固着して立設し前記電子部品の側方を覆う側壁部と、当該側壁部に支持され前記基板の面に対して離間して位置し前記電子部品の上方を覆う天板部と、を備えており、

前記シールドの前記側壁部のうち、前記基板の前記一方の面側に前記電子部品が配置されている箇所に位置する前記側壁部の一部が切除されている、
回路基板の製造方法。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の回路基板の製造方法であって、

前記基板の前記他方の面上における前記シールドの前記側壁部の前記切除箇所が形成された箇所に、配線を敷設した、

回路基板の製造方法。